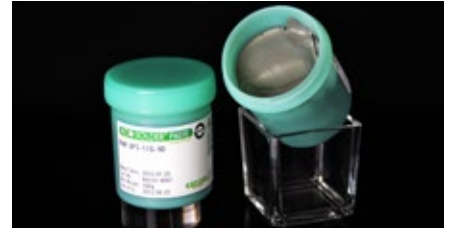


### ボイドを抑制した水平実装で、高放熱特性を実現

Achieves excellent heat dissipation characteristics in horizontal packaging that suppresses void formation

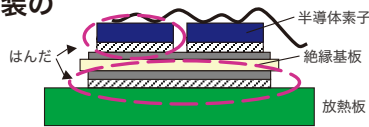
#### 特長

- はんだ厚や傾斜に起因するクラックを抑制、放熱性の高い実装を実現
- 傾斜なきベアチップは、信頼性の高いワイヤーボンディングが可能
- 独自工法による均一球形のNiボールを最適配合し、ボイドを低減

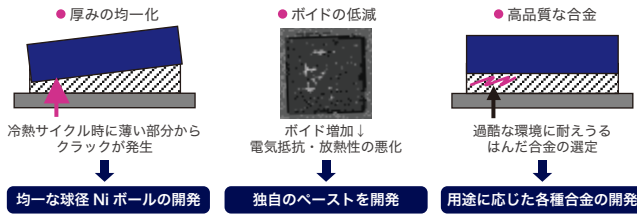


#### 仕様

#### ● パワーデバイス実装の課題解決

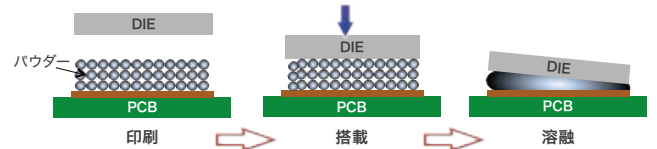


#### パワーデバイス実装の課題解決

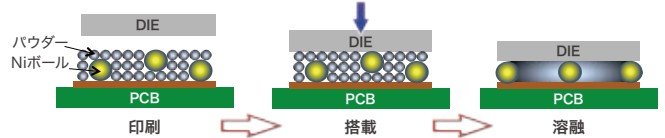


#### ● Niボール入り溶ダペーストで、水平実装を実現

通常の溶ダペーストは、チップが傾斜するリスクがある

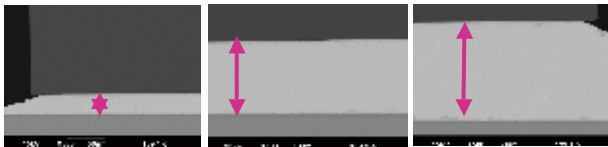


Ni入り溶ダペーストは、スペーサー効果により水平実装を実現

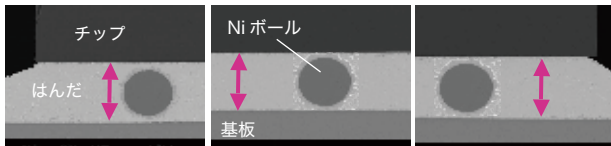


#### ● 均質な独自工法によるNiボールが、高い放熱性を実現

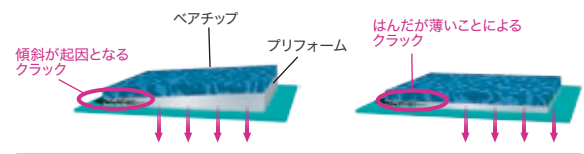
##### ● Ni ボール無しの場合



##### ● Ni ボール入りの場合



クラックの空気層が、熱伝導性を阻害し放熱効果を低下させる



良好な放熱性

Niボールがはんだ厚バラツキを抑制

